

# Declaration and Power of Attorney for Patent Application

## 特許出願宣言書および委任状

### Japanese Language Declaration

私は下記発明者として以下の通り宣言します：

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、郵送先、および国籍は私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, mailing address and citizenship are as stated next to my name.

下記名称の発明に関し請求範囲に記載され特許出願がされている発明内容につき、私が最初、最先かつ唯一の発明者（下記氏名が一つの場合）であるか、あるいは最初、最先かつ共同発明者（下記氏名が複数の場合）であると信じます。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING A Cu

INTERCONNECTION AND METHOD FOR

MANUFACTURING THE SAME

下記項目にx印が付いている場合を除き、上記発明の明細書は本書に添付されます。

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

☐

上記発明は米国出願番号あるいはPCT国際出願番号\_\_\_\_（確認番号\_\_\_\_）として\_\_\_\_年\_\_月\_\_日に出願され、\_\_\_\_年\_\_月\_\_日に補正されました（該当する場合）。

☐

was filed on \_\_\_\_\_ as United States Application Number or PCT International Application Number \_\_\_\_\_ (Conf. No. \_\_\_\_\_) and was amended on \_\_\_\_\_ (if applicable).

私は特許請求範囲を含み上述の補正で補正された前記明細書の内容を検討し、理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は連邦規則法典第37編1条56項に定義される特許性に肝要な情報について開示義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

## Japanese Language Declaration

私は米国法典第35編119条(a)-(d)あるいは365条(b)に基づき特許あるいは発明者証書の下記外国出願、または365条(a)に基づき米国以外の少なくとも1ヶ国を指定した下記PCT外国出願についての外国優先権をここに主張するとともに、下記項目にx印を付けることにより優先権を主張する出願以前の出願日を有する特許あるいは発明者証書の外国出願あるいはPCT外国出願を示します。

Prior foreign application(s)  
外国での先行出願

2003-016700

Japan

(Number)  
(番号)

(Country)  
(国名)

(Number)  
(番号)

(Country)  
(国名)

私は米国法典第35編119条(e)に基づき下記の米国仮特許の利益をここに主張します。

(Application No.)  
(出願番号)

(Filing Date)  
(出願日)

(Application No.)  
(出願番号)

(Filing Date)  
(出願日)

私は米国法典第35編120条に基づき下記米国特許出願、あるいは365条(c)に基づき米国を指定する下記PCT国際特許出願の利益をここに主張し、本特許出願内特許請求範囲の各項目の内容が米国法典第35編112条の最初の項に規定される方法により先行米国あるいはPCT国際特許出願で開示されていない限りにおいて連邦規則法典第37編1条56項に定義される特許性に肝要で、先行特許出願の出願日から本特許出願の国内あるいはPCTの出願日までの間に入手された情報について開示義務があることを認めます。

(Application No.)  
(出願番号)

(Filing Date)  
(出願日)

(Application No.)  
(出願番号)

(Filing Date)  
(出願日)

私は本宣言書内で私自身の知識に基づいてなされたすべての陳述が真実であり、情報および信ずるところに基づいてなされたすべての陳述が真実であると信じられていることをここに宣言し、さらに故意になされた虚偽の陳述等々は米国法典第18編1001条に基づき罰金あるいは拘禁または両方による処罰にあたり、またかような故意による虚偽の陳述はそれに基づく特許出願あるいは成立特許の有効性を危うくする可能性があることを認識した上でこれらの陳述をなしたことを宣言します。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, § 119(a)-(d) or § 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below, and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Claimed  
優先権の主張

Yes No  
有り 無し  
☐ ☐

24/01/03

(Day/Month/Year Filed)  
(出願年月日)

(Day/Month/Year Filed)  
(出願年月日)

☐ ☐

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, § 120 of any United States application(s), or § 365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, § 112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

(Status: patented, pending, abandoned)  
(状態: 特許成立済、係属中、放棄済)

(Status: patented, pending, abandoned)  
(状態: 特許成立済、係属中、放棄済)

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

## Japanese Language Declaration

委任状：私は下記の米国特許商標局（USPTO）顧客番号のもとに記載される SUGHRUE MION 法律事務所のすべての弁護士を、同顧客番号のもとに記載される個々の弁護士は Sughrue Mion 法律事務所のための自由裁量に基づき変更され得ることを認識した上で、本特許出願の手続きおよびそれに関わる特許商標局との業務を遂行する弁護士として指名し、本特許出願に関するすべての通信が同 USPTO 顧客番号のもとに提出された住所宛に送付されることを要請します。

POWER OF ATTORNEY: I hereby appoint all attorneys of SUGHRUE MION, PLLC who are listed under the USPTO Customer Number shown below as my attorneys to prosecute this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith, recognizing that the specific attorneys listed under that Customer Number may be changed from time to time at the sole discretion of Sughrue Mion, PLLC, and request that all correspondence about the application be addressed to the address filed under the same USPTO Customer Number.



23373

PATENT TRADEMARK OFFICE

電話連絡は下記へ：（名前および電話番号）

SUGHRUE MION, PLLC  
+1 (202) 293-7060

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

SUGHRUE MION, PLLC  
(202) 293-7060

唯一あるいは第一の発明者名	Full name of sole or first inventor Takashi TONEGAWA
発明者の署名 日付	Inventor's signature <i>Takashi Tonegawa</i> (Seal) Date January 14, 2004
住所	Residence Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship Japanese
郵送先	Mailing Address c/o NEC Electronics Corporation, 1753 Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-8668, Japan
第二の共同発明者（該当する場合）	Full name of second joint inventor, if any
第二発明者の署名 日付	Second inventor's signature Date
住所	Residence
国籍	Citizenship
郵送先	Mailing Address